

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 9 月 22 日(22.09.2011)

PCT

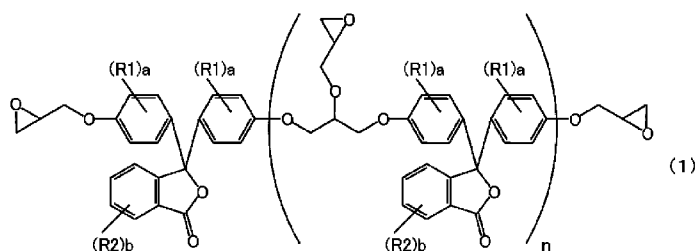
(10) 国際公開番号
WO 2011/114687 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08G 59/20 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/001460
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 14 日(14.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-057531 2010 年 3 月 15 日(15.03.2010) JP
特願 2010-057530 2010 年 3 月 15 日(15.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 祐介 (TANAKA, Yusuke) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T Gビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

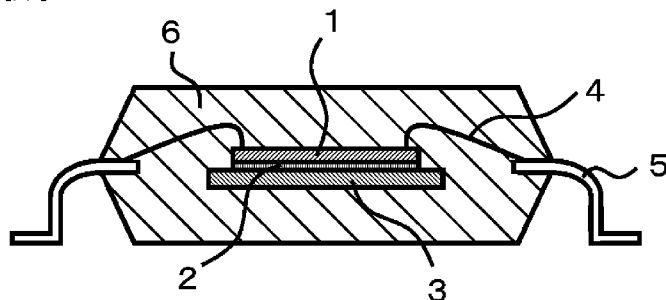
[続葉有]

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTORS, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 半導体封止用樹脂組成物およびこれを用いた半導体装置



[図1]



(57) Abstract: Provided is a resin composition for sealing semiconductors which includes an epoxy resin (A), a curing agent (B) and an inorganic filler (C). Therein, the epoxy resin (A) includes an epoxy resin (A-1) represented by formula (1), and the epoxy resin (A-1) includes a component represented by formula (1) wherein $n \geq 1$ and a component (a1) represented by formula (1) wherein $n=0$. (In formula (1), R1 represents a hydrocarbon group with 1-6 carbon atoms, R2 represents a hydrocarbon group with 1-6 carbon atoms or an aromatic hydrocarbon group with 6-14 carbon atoms and can be the same as R1 or different from R1, a is an integer in the range of 0-4, b is an integer in the range of 0-4 and n is an integer not less than zero).

(57) 要約: 本発明によれば、エポキシ樹脂(A)と、硬化剤(B)と、無機充填材(C)とを含み、前記エポキシ樹脂(A)が式(1)で表されるエポキシ樹脂(A-1)を含み、前記エポキシ樹脂(A-1)が、前記式(1)において $n \geq 1$ である成分と、前記式(1)において $n=0$ である成分(a1)とを含む、半導体封止用樹脂組成物が提供される(式(1)にお

いて、R1は炭素数1～6の炭化水素基であり、R2は炭素数1～6の炭化水素基または炭素数6～14の芳香族炭化水素基であり、互いに同じであっても異なってもよく、aは0～4の整数であり、bは0～4の整数であり、nは0以上の整数である。)